

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年10月20日(2005.10.20)

【公開番号】特開2004-31432(P2004-31432A)

【公開日】平成16年1月29日(2004.1.29)

【年通号数】公開・登録公報2004-004

【出願番号】特願2002-181809(P2002-181809)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 25/065

H 01 L 21/60

H 01 L 25/07

H 01 L 25/18

【F I】

H 01 L 25/08 Z

H 01 L 21/60 3 2 1 E

【手続補正書】

【提出日】平成17年6月21日(2005.6.21)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

実装基板と、

上面に電極パッドを有する第1の半導体チップと、

上面に電極パッドを有する第2の半導体チップと、

上面に電極パッドを有する第3の半導体チップと、を有し、

前記第1の半導体チップ及び前記第2の半導体チップが、それぞれの下面を前記実装基板に対向させ、互いに接着テープ上の導体パターンを介して電気的に接続され、かつ、互いの側面同士を近接させて、前記実装基板上に搭載されており、

前記第3の半導体チップが、前記第1の半導体チップ及び前記第2の半導体チップの上面に、前記互いに近接された側面の上に位置するように搭載され、

前記第3の半導体チップの電極パッドが、前記実装基板とボンディングワイヤを介して電気的に接続され、

前記第1の半導体チップの電極パッドのいくつかと、前記第2の半導体チップの電極パッドのいくつかが、前記実装基板とボンディングワイヤを介して電気的に接続され、

前記接着テープ及び前記接着テープ上の導体パターンが、前記互いに近接された側面の上を跨っており、

前記第3の半導体チップが、前記接着テープ上に配置されていることを特徴とする半導体装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 9】

【課題を解決するための手段】

この発明の半導体装置は、実装基板と、上面に電極パッドを有する第1の半導体チップと、上面に電極パッドを有する第2の半導体チップと、上面に電極パッドを有する第3の半導体チップと、を有し、前記第1の半導体チップ及び前記第2の半導体チップが、それぞれの下面を前記実装基板に対向させ、互いに接着テープ上の導体パターンを介して電気的に接続され、かつ、互いの側面同士を近接させて、前記実装基板上に搭載されており、前記第3の半導体チップが、前記第1の半導体チップ及び前記第2の半導体チップの上面上に、前記互いに近接された側面の上に位置するように搭載され、前記第3の半導体チップの電極パッドが、前記実装基板とボンディングワイヤを介して電気的に接続され、前記第1の半導体チップの電極パッドのいくつかと、前記第2の半導体チップの電極パッドのいくつかが、前記実装基板とボンディングワイヤを介して電気的に接続され、前記接着テープ及び前記接着テープ上の導体パターンが、前記互いに近接された側面の上を跨っており、前記第3の半導体チップが、前記接着テープ上に配置されているものである。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0011

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0012

【補正方法】削除

【補正の内容】

【手続補正6】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】削除

【補正の内容】